

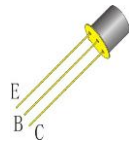
3DG5551 型硅 NPN 高频小功率晶体管

1、特性

芯片采用硅外延平面结构，器件采用 A3-01B 型金属封装和 SMD-0.2、UB 型金属陶瓷封装。

器件具有特征频率高、体积小、重量轻，可靠性高的特点。

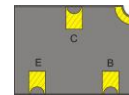
器件的静电放电敏感度为 3A 级 4000V，A3-01B 典型重量 0.35g，SMD-0.2 典型重量 0.45g，UB 典型重量 0.04g。



A3-01B 型



SMD-0.2 型



UB 型

注：SMD-0.2 封装产品型号后缀加“U”标识，UB 封装产品型号后缀加“UB”标识。

2、质量等级及执行标准

G、G+:Q/RBJ2106（UB 型），Q/RBJ1001QZ（A3-01B、SMD-0.2 型），QZJ840611。

3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号	$P_{\text{tot1}}^{\text{a}}$ mW	$P_{\text{tot2}}^{\text{b}}$ mW	I_{CM} mA	V_{CBO} V	V_{CEO} V	V_{EBO} V	$T_{\text{stg}}, T_{\text{j}}$ $^{\circ}\text{C}$
3DG5551	500	1000	600	180	160	6	-55~175
^a P_{tot1} 为 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，不加散热片时的最大额定功率； $T_A>25^{\circ}\text{C}$ 时,按 3.33mW/ $^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。 ^b P_{tot2} 为 $T_C=25^{\circ}\text{C}$ 时的最大额定功率； $T_C>25^{\circ}\text{C}$ 时,按 6.67mW/ $^{\circ}\text{C}$ 线性地降额。							

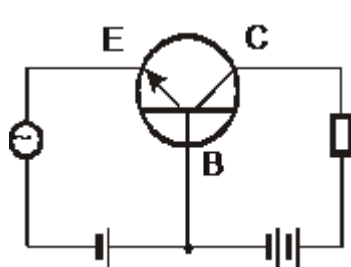
4、主要电特性

主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

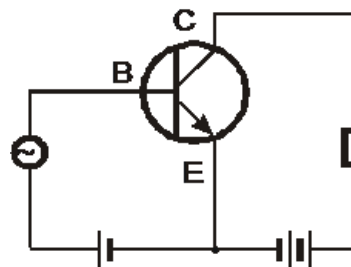
参 数		数 值			单 位
符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	
$V_{(\text{BR})\text{CBO}}$	$I_{\text{C}}=0.1\text{mA}$	180	—	—	V
$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	$I_{\text{C}}=0.1\text{mA}$	160	—	—	V
$V_{(\text{BR})\text{EBO}}$	$I_{\text{E}}=0.1\text{mA}$	6	—	—	V
I_{CBO}	$V_{\text{CB}}=120\text{V}$	—	30	50	nA
I_{EBO}	$V_{\text{EB}}=4\text{V}$	—	30	50	nA
h_{FE}	$V_{\text{CE}}=5\text{V}, I_{\text{C}}=10\text{mA}$	80	—	250	—
$V_{\text{BE}(\text{sat})}$	$I_{\text{C}}=10\text{mA}, I_{\text{B}}=1\text{mA}$	—	0.8	1.0	V
$V_{\text{CE}(\text{sat})}$	$I_{\text{C}}=10\text{mA}, I_{\text{B}}=1\text{mA}$	—	0.15	0.2	V
f_{T}	$V_{\text{CE}}=10\text{V}, I_{\text{C}}=10\text{mA}, f=100\text{MHz}$	100	200	300	MHz
C_{ob}	$V_{\text{CB}}=10\text{V}, I_{\text{E}}=0, f=1\text{MHz}$	—	5	10	pF

5、典型电路应用图

器件在电子线路中主要有两种接线法，如图所示：



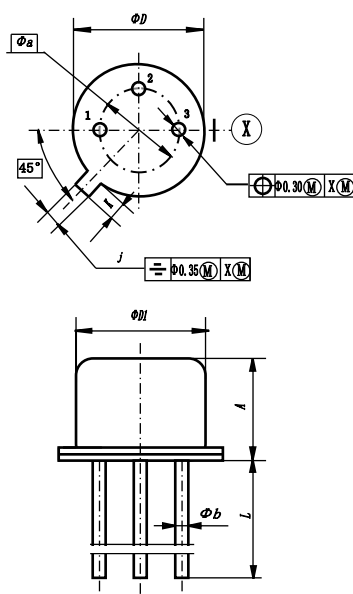
共基极接线法



共发射极接线法

6、外形尺寸

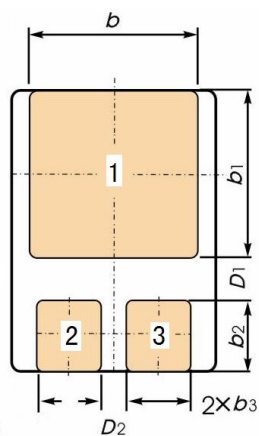
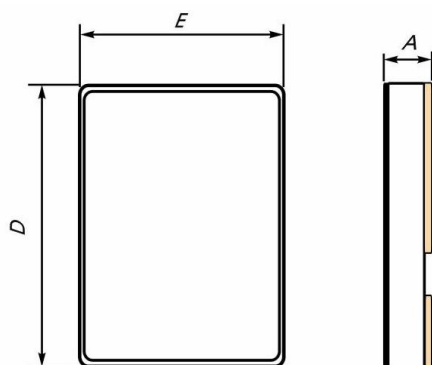
单位为毫米



尺寸符号	数值		
	最小值	典型值	最大值
A	4.32	—	5.33
Φa	—	2.54	—
Φb	0.407	—	0.508
ΦD	5.31	—	5.84
ΦD_1	4.53	—	4.95
j	0.92	1.04	1.16
K	0.51	—	1.21
L	12.5	—	25.0

A3-01B 外形尺寸

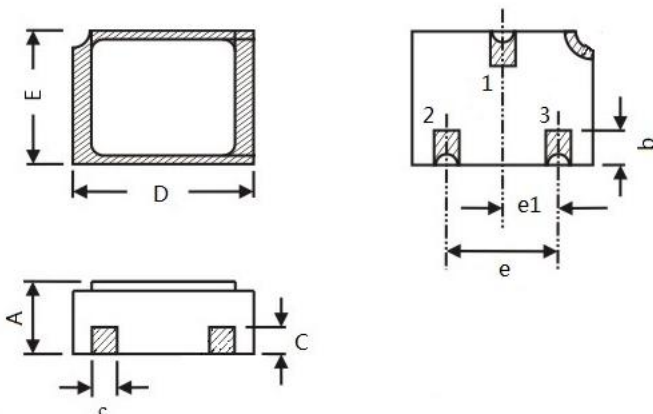
单位为毫米



SMD-0.2 外形尺寸

尺寸符号	数值	
	最 小 值	最 大 值
A	2.41	3.34
b	4.85	5.45
b_1	4.40	5.15
b_2	1.75	2.15
b_3	1.85	2.25
D	7.77	8.13
D_1	0.50	—
D_2	0.60	—
E	5.23	5.64

单位为毫米



尺寸符号	数 值	
	最小值	最大值
<i>A</i>	1.12	1.47
<i>b</i>	0.56	0.96
<i>C</i>	0.43	0.89
<i>c</i>	0.35	0.67
<i>D</i>	2.82	3.35
<i>E</i>	2.16	2.74
<i>e</i>	1.76	2.07
<i>e₁</i>	0.85	1.02

UB 外形尺寸

7、使用和维护

7.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大。

A3-01B 型封装，引出端直径 0.407mm~0.508mm。在安装、测试等过程中不允许多次折弯和施应力，否则易造成引脚折断或玻璃绝缘子裂缝，影响其密封性。SMD-0.2、UB 型金属陶瓷封装，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，否则易造成陶瓷金属裂缝，影响其密封性。

焊接安装时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃ 下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

7.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按照规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。

如发生不可预期情况或误操作造成器件损坏等情况，请与供应商联系。